混練におけるナノファイバー分散過程の 微視的シミュレーション

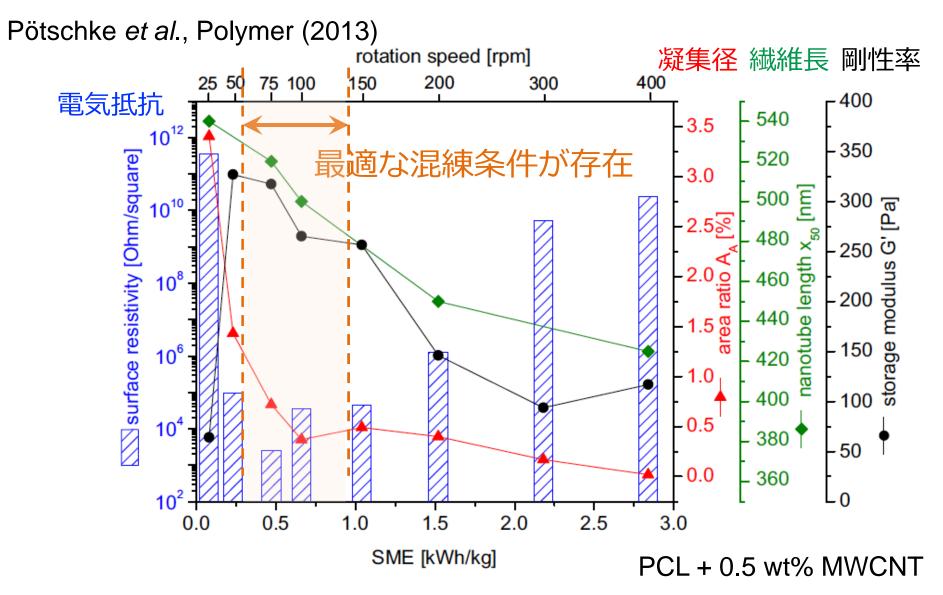
○ 辰巳 怜 (東大環安セ)

小池 修 (PIA)

山口由岐夫 (PIA)

辻 佳子 (東大環安セ/東大院工)

混練条件とファイバー分散

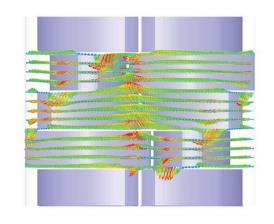


ファイバーの分散と破壊のトレードオフ

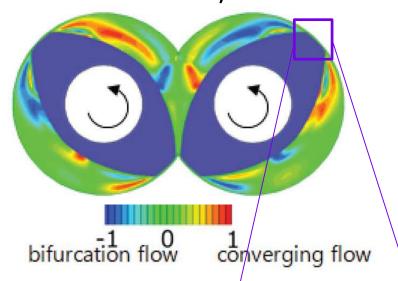
数値シミュレーション

·装置内流動解析(巨視的スケール)

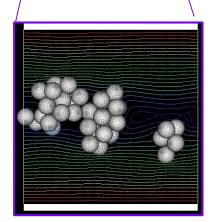
装置形状,操作条件 → 流動状態(剪断率,流動様式)



Nakayama et al., AIChE J. (2018).



- ・フィラー分散過程の解析(微視的スケール)
 - 流動状態 (剪断率,流動様式)
 - → 分散過程(解砕,破壊,均一化)



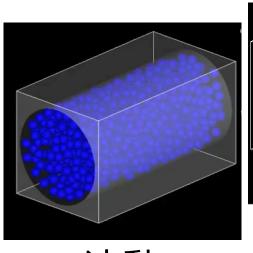
直接数値シミュレーション

Direct Numerical Simulation

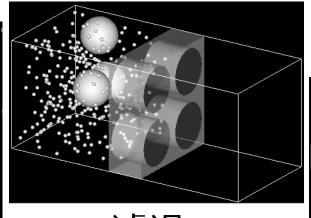
粒子:運動方程式

流体力 ↑ 境界条件 ← 連成:Immersed Boundary 法

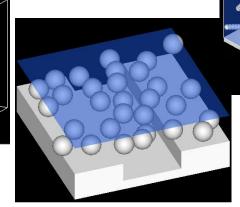
流動場: Navier-Stokes方程式



流動



濾過



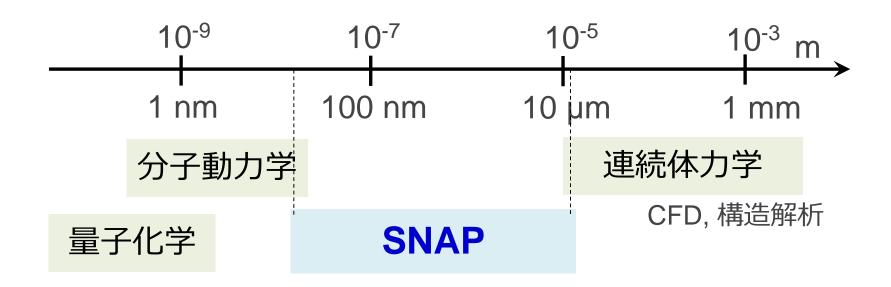
乾燥

SNAP研究会



Structure of NAno Particles 粒子分散系プロセスの課題解決

空間スケールとモデル



詳細設計

概念設計

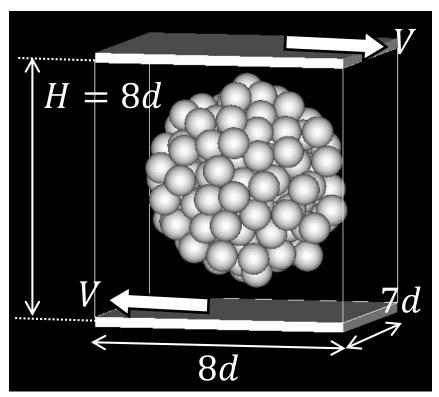
詳細設計

SNAP解析事例

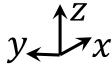
単純剪断流れにおける凝集体解砕

- ・凝集体径 6d 一次粒子径 d体積分率 18 vol%
- ·剪断率 $\dot{\gamma} = 2V/H$
- ・無次元剪断率

$$\Gamma = \frac{\eta \dot{\gamma} d^3}{E} = \frac{$$
剪断エネルギー
凝集エネルギー



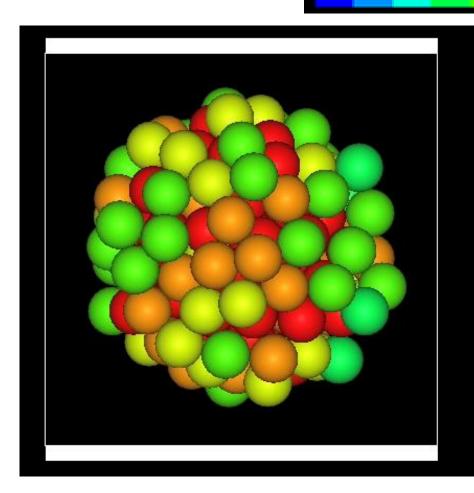
周期境界条件: x, y

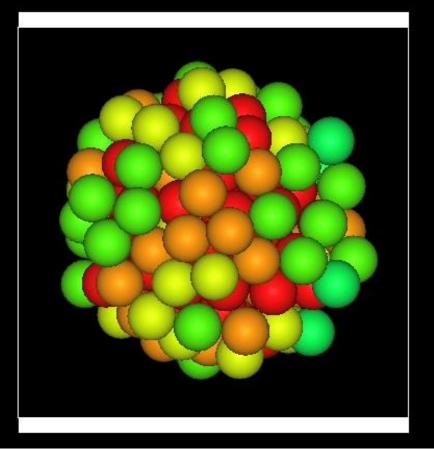


辰巳ら, プラスチック成形加工学会 第26回秋季大会 (2018)

計算結果

0 接触数 6





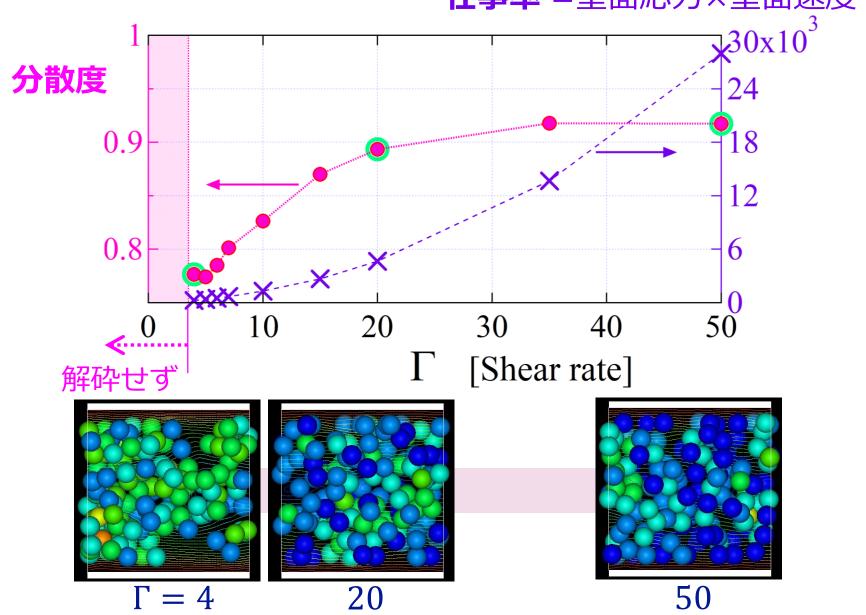
$$\Gamma = 4$$

$$\Gamma = 20$$

分散度 vs. 剪断率

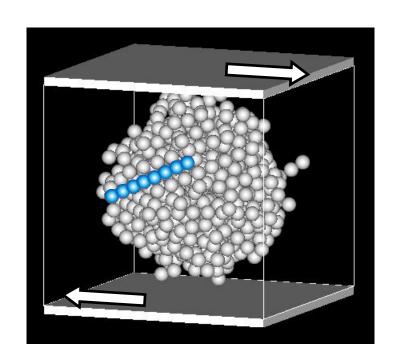
単位: $E^2/\eta d^3$

仕事率 =壁面応力×壁面速度



目的

- ・ファイバー凝集体の分散過程の解析
 - ← 直接数値シミュレーション (SNAP)
- ・トレードオフ解決のための混練条件の考察 ファイバーの分散 vs. 破壊



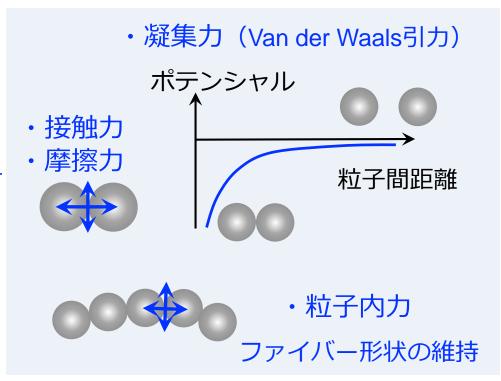
基礎方程式

粒子:運動方程式

流体力 粒子間力

並進
$$M \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = F^{\mathrm{H}} + F^{\mathrm{PP}}$$

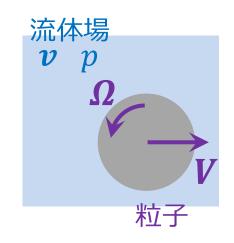
回転
$$I\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t} = N^{\mathrm{H}} + N^{\mathrm{PP}}$$



流体場: Navier-Stokes方程式

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \nabla \boldsymbol{v}\right) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{f}_{P} \quad \text{粒子速度 境界条件の強制 流体応力 }$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0 \qquad \qquad \boldsymbol{\sigma} = -p\boldsymbol{I} + \boldsymbol{\eta} [\nabla \boldsymbol{v} + (\nabla \boldsymbol{v})^{\mathsf{T}}]$$



計算条件

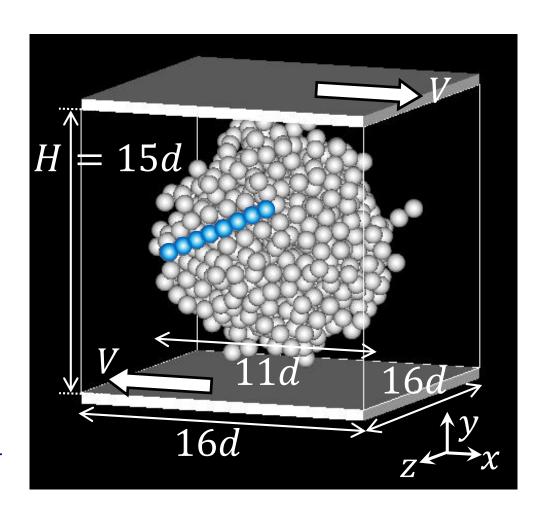
粒子

- ・直径 $d=11 \, \mathrm{nm}$ (バンドル径)
- ・アスペクト比 8
- · 体積分率 11 vol%

剪断率 $\dot{\gamma} = 2V/H$

無次元剪断率

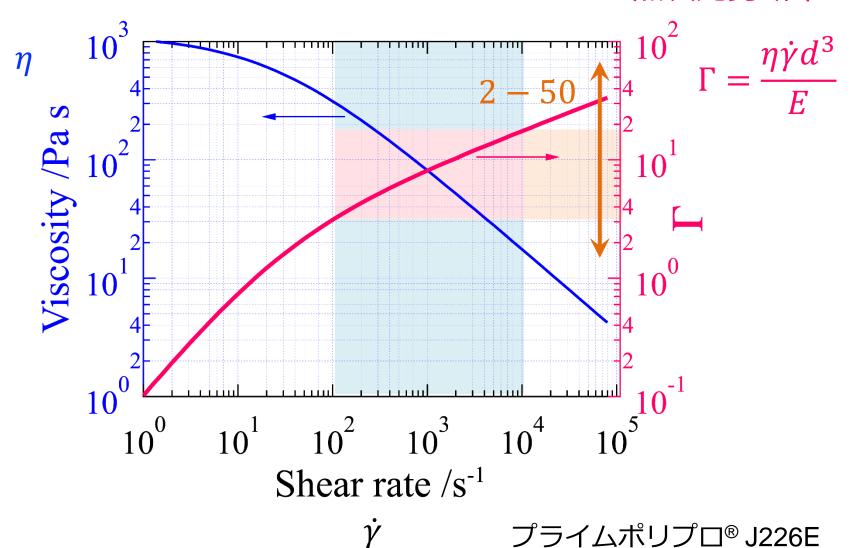
$$\Gamma = \frac{\eta \dot{\gamma} d^3}{E} = \frac{$$
剪断エネルギー
凝集エネルギー



計算条件

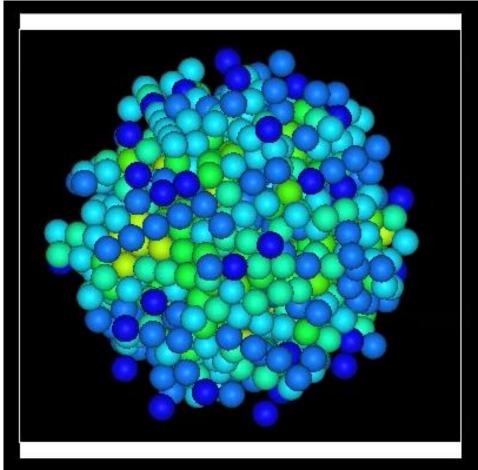
CNT凝集エネルギー $E \sim 10^{-20}$ J

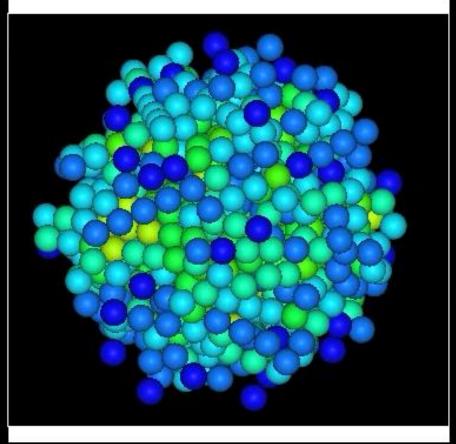
無次元剪断率



計算結果

6 接触数 8





$$\Gamma = 2$$

$$\Gamma = 6$$

評価量

分散度

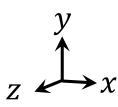
 $1-\frac{平均接触数}{初期平均接触数}$

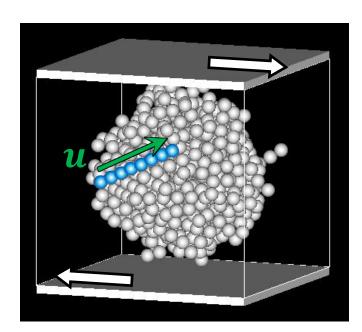
壁面応力

媒質粘度×剪断率 で無次元化

配向度: $\langle u_x^2 \rangle$, $\langle u_y^2 \rangle$, $\langle u_z^2 \rangle$

粒子長軸方向の単位ベクトル $\mathbf{u}=(u_x,u_y,u_z)$



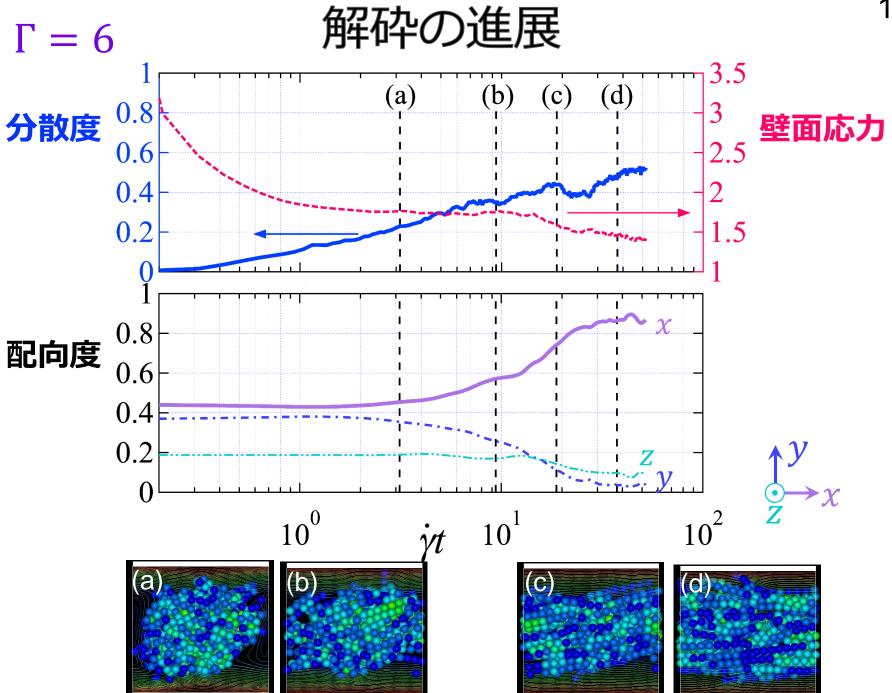


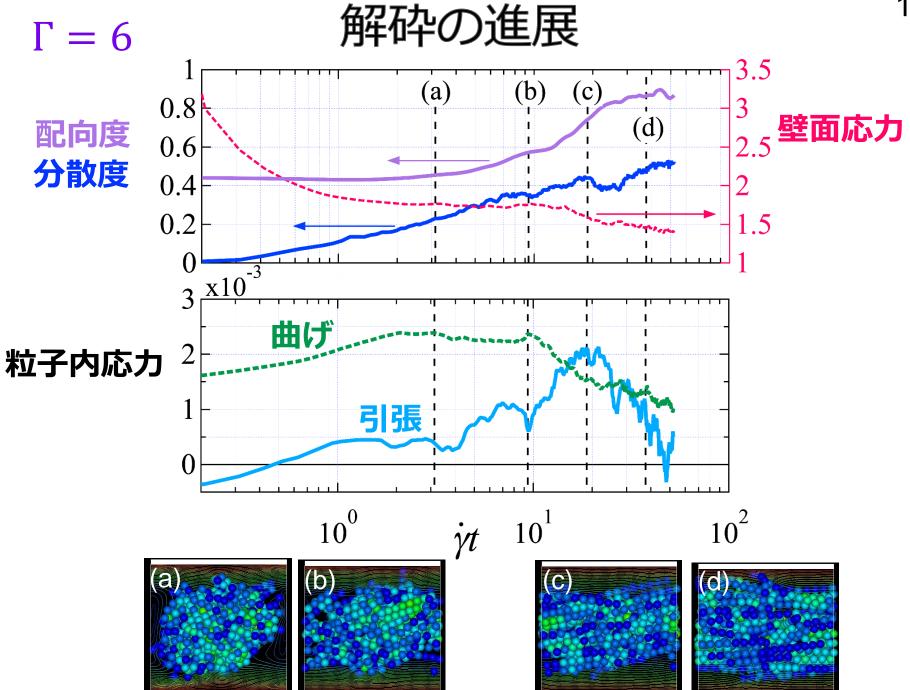
粒子内応力

- · 引張応力
- ・曲げ応力

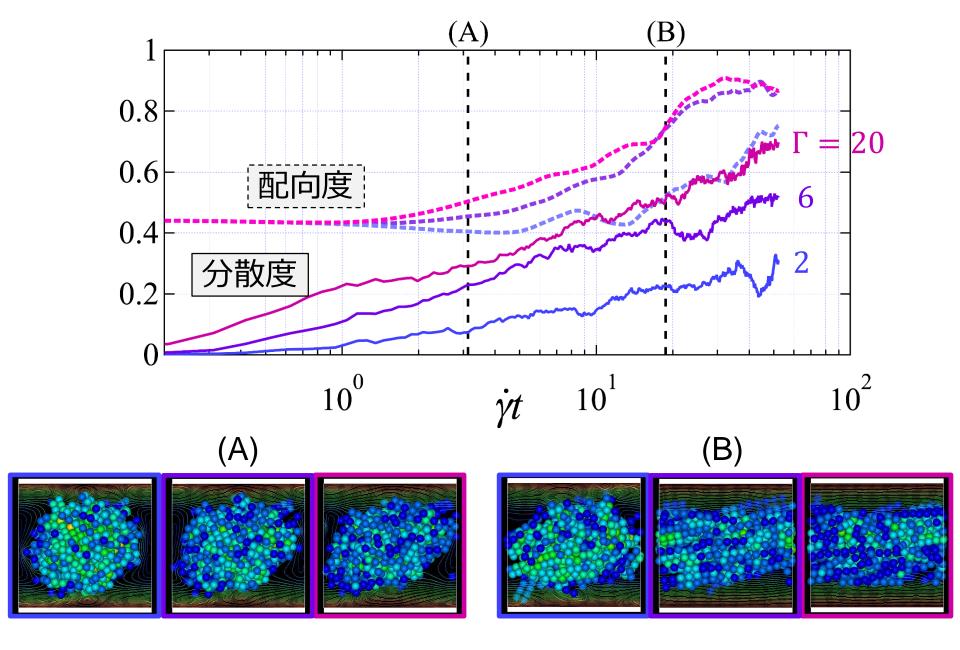
無次元化

Young率で無次元化

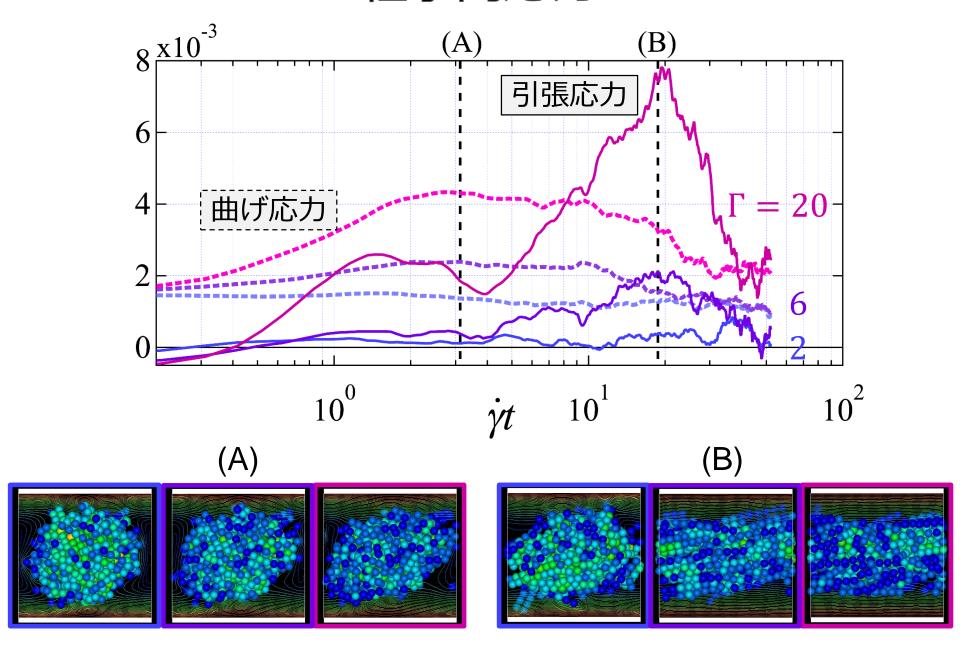




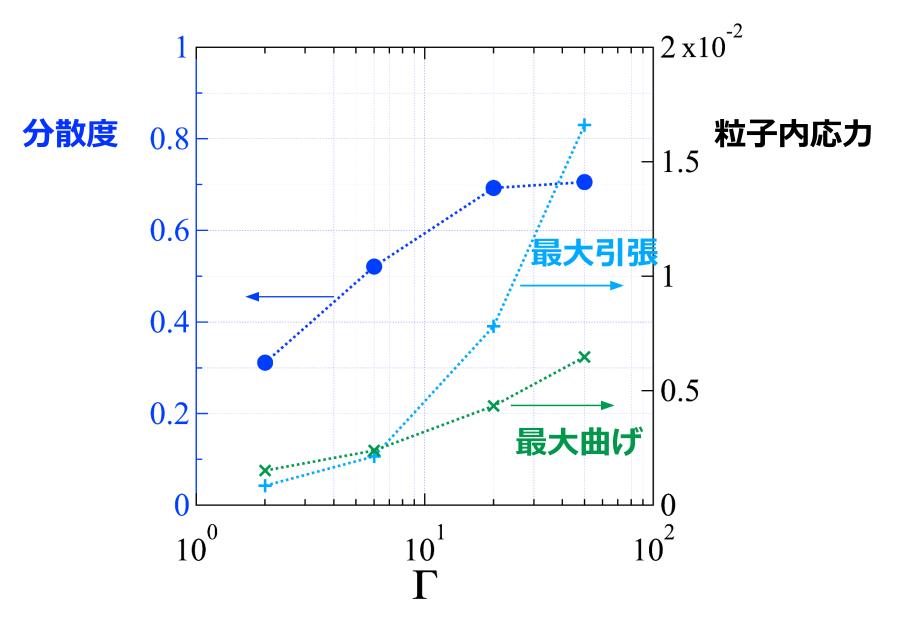
分散度 配向度



粒子内応力



計算結果



総括

- ・SNAPによる分散過程の可視化 凝集体解砕 → 配向の順で進行; 壁面応力の減少と対応
- ・主要な粒子内応力(破壊モード)が変化曲げ(解砕段階) → 引張(配向段階) (低剪断率) (高剪断率)

- ・剪断率増加に対する上昇率: 分散度:小 粒子内応力:大 → 最適な剪断率が存在
- ・今後:ファイバー破壊を考慮した解析